

盛合晶微半导体有限公司 (SJ Semiconductor Corporation) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“盛合晶微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕373号文同意注册。《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网/金融时报网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	0.00001 美元
发行股数	本次向社会公众发行 25,546.6162 万股，占公司发行后总股本的比例约为 13.71%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股）	19.68
发行人高级管理人员、员	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专

工参与战略配售情况（如有）	项资产管理计划参与战略配售数量为 16,006,097 股，占本次发行数量的 6.27%，获配金额 314,999,988.96 元。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 36 个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司中国中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为 5,109,323 股，占本次发行数量的 2.00%，获配金额为 100,551,476.64 元。中国中金财富证券有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	0.12 元（以 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前已发行股份总数计算）
发行后每股收益	0.10 元（以 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后已发行股份总数计算）
发行市盈率	195.62 倍（每股收益按 2024 年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	1.94 倍（按发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	8.77 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份总数计算）
发行后每股净资产	10.13 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后已发行股份总数计算）
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	502,757.41 万元
募集资金净额（万元）	477,860.11 万元
发行费用概算	<p>本次发行费用为 24,897.30 万元，明细如下：</p> <p>（1）保荐承销费用：19,984.61 万元，上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；</p> <p>（2）审计及验资费：2,745.40 万元，费用以工作人员的工作量为基础计算，按照项目进度分节点支付，付款节点根据工作量情况协商确定；</p> <p>（3）律师费：1,590.00 万元，费用基于工作量、市场平均律师费用水平等因素综合约定，按照项目进度分节点支付；</p> <p>（4）信息披露费用：535.00 万元，</p> <p>（5）上市相关的手续费等其他费用：42.29 万元</p> <p>（注：以上费用均已包含增值税）</p>
发行人和保荐人（联席主承销商）	

发行人	盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）		
联系人	周燕	联系电话	0510-86975899
保荐人（联席主承销商）	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620561
联席主承销商	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	0755-23835515 0755-23835516

发行人：盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2026年4月15日

（此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

发行人：盛合晶微半导体有限公司
（SJ Semiconductor Corporation）

2026年4月15日

(此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司 (SJ Semiconductor Corporation) 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



(此页无正文, 为《盛合晶微半导体有限公司 (SJ Semiconductor Corporation)
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)

联席主承销商: 中信证券股份有限公司



2016年4月15日